



S34SL01G200BHI003

Număr parc	S34SL01G200BHI003	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Cypress Semiconductor	Starea stocului	5615 pcs stock
Descriere produs	IC FLASH 1GBIT PARALLEL 63BGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de S34SL01G200BHI003

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	-	Tensiune - Aprovizionare	2.7V ~ 3.6V
Tehnologie	FLASH - NAND	Pachetul dispozitivului furnizor	63-BGA (11x9)
Serie	SL-2	Pachet / Caz	63-VFBGA
Pachet	Tape & Reel (TR)	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Non-Volatile
Dimensiunea memoriei	1Gbit	Organizarea memoriei	128M x 8
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	FLASH
Numărul produsului de bază	S34SL01	Timpul de acces	25 ns

Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake de date, vehicule și PV

2023/09/7

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrate

2023/08/21

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

2023/03/15

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22